

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-14

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	浙商证券、富国基金、野村证券等机构投资者
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2026年6月15日-16日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍 2026 年一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年一季度，PCB 通信、数据中心占 PCB 收入占比环比增加；受消费周期影响，汽车电子收入占比有所下降，其余占比维持稳定。</p> <p>Q2、请介绍 2026 年一季度封装基板业务经营拓展情况。</p> <p>公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2026 年一季度，受益于处理器芯片类封装基板需求增加、存储类封装基板收入持续增长，公司封装基板业务收入占比环比提升。</p>

Q3、请介绍公司近期产能利用率情况。

近期公司综合产能利用率处于高位，其中公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q4、请介绍公司南通四期及泰国项目爬坡进展。

泰国工厂与南通四期项目于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。因为该项目仍处于爬坡早期阶段，在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高，会对公司利润产生一定影响。公司将持续加强内部能力建设，提前做好潜在难点识别，加快重点客户项目引入进程，尽可能缩短爬坡周期，为业务的进一步拓展提供支持。

Q5、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。

2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。

Q6、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年继续受到大宗商品价格变化的影响，覆铜板、铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q7、请介绍公司 2026 年资本开支的方向。

2026 年公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡高速高密、高多层电子电路产品项目、广州封装基板工厂建设，以及南通四期、泰国工厂项目后续款项支付；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。

Q8、请介绍公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品募投项目情况。

	<p>公司无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目总投资 45.36 亿元，其中拟使用募集资金投入 36 亿元，主要生产公司现有高速高密高多层 PCB 产品，用于 AI 服务器、交换机等领域。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>